

DWG. NO.
SD-55087-001

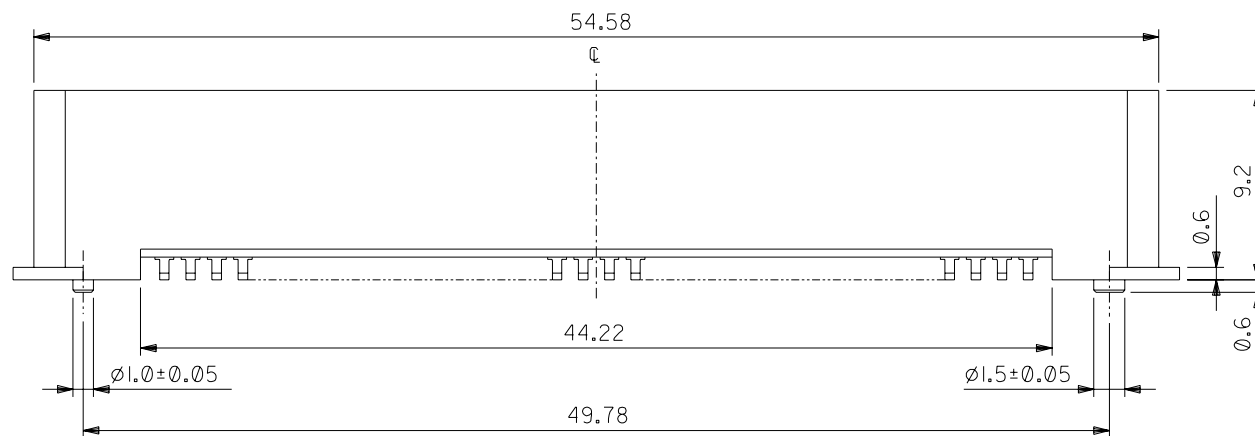
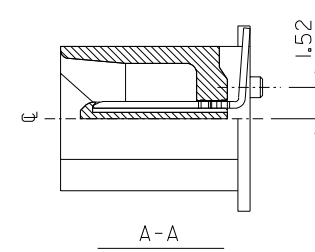
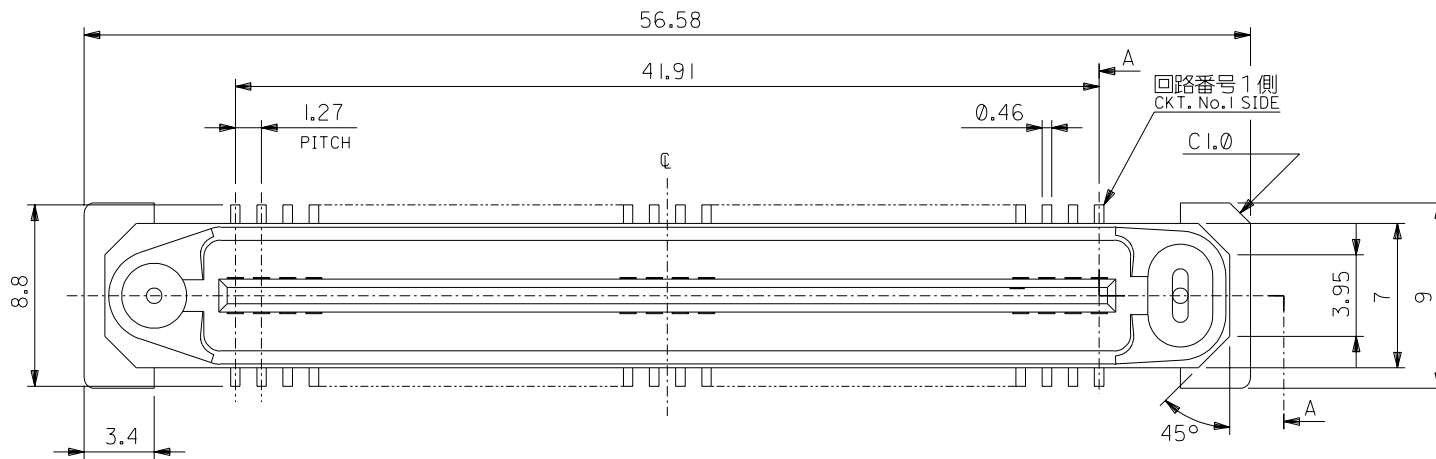
E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

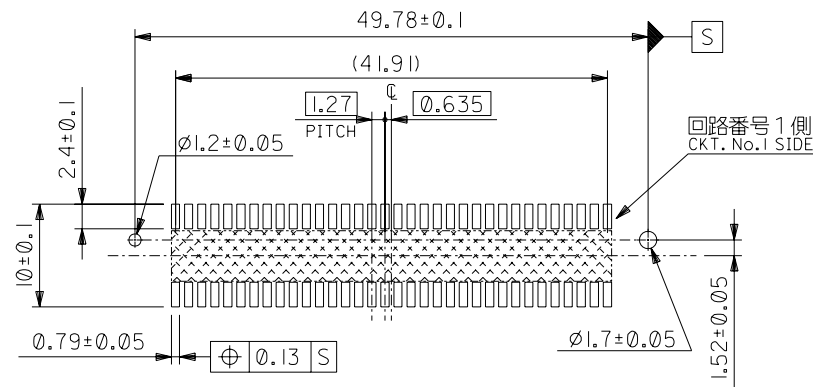
B

A



注記
NOTES:

- 材質
MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、黒色、UL94V-0
HOUSING : G.F.LCP, BLACK, UL94V-0
ターミナル: 焼青銅
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様
PLATING
ターミナル: 接点部: 金メッキ 0.76μmMIN.
TERMINAL : CONTACT AREA : GOLD 0.76 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部: 錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 71660-7068 | PS-71660/55087 |
| 嵌合相手
MATED CONN. | 納入仕様書
PRODUCT SPECIFICATION |
- テール平坦度: 0.1 MAX.
TAILS COPLANARITY: 0.1 MAX.
- 本製品は55087-6811の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55087-6811.



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE 2:1)

VIA HOLE 禁止領域
NO VIA HOLES IN THIS AREA.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —
DRAWN BY 04/04/28 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/04/28 K.TOJO
APP'D BY 04/04/28 M. Saito	尺度 SCALE 4 : 1

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —
DRAWN BY 04/04/28 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/04/28 K.TOJO
APP'D BY 04/04/28 M. Saito	尺度 SCALE 4 : 1

55087-**19	55087-6819	68
MODEL No.	MATERIAL No.	CKTS.
molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
TITLE 名称 EBB1 50D VERTICAL BLIND MATE CONN. SMT PLUG HS'G ASSY -LEAD FREE-		
DWG. NO.	SD-55087-001	REV 0